

# CHO-BOND-1030硅脂导电胶

产品名称	CHO-BOND-1030硅脂导电胶
公司名称	海邦实业上海有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:1 型号:1 1:1
公司地址	上海市松江区洞泾镇莘砖公路3366号1幢
联系电话	18017259379

## 产品详情

硅脂导电胶是在利用硅脂的高粘性和金属颗粒的高导电巧妙结合成的。依据组成成份，可分单组份和双组份；依据填充的导电颗粒可

分为填银硅脂胶、填镍硅脂胶、铜镀银硅脂胶、铝镀银硅脂胶、石墨镀镍导电胶等。

其中CHO-BOND -1030是一种但成分RTV硅酮，它暴露在中等潮湿环境下固化，具有2倍与其他RTV硅酮的撕裂强度和200psi ( 1.38MPa ) 的搭接剪切

强度。为了导电率，粘合层厚度不应超过10mil。为了正确的固化，宽度不应该超过0.5i ( 1.27cm )。材料在1-2psi

( 0.01Mpa ) 标准压力和不超过66 的温度下固化。

应用：导电橡胶板与金属粘接、导电橡胶条与金属粘接

使用方法：一定要将需要粘接的表面清洗干净后，后按规定操作。

技术参数：体电阻：0.05 剥离强度：14Kg/cm<sup>2</sup>工作温度：-55 ~ 200 操作时间：30分钟温室固化时间：7天存储期：6个月粘接面积：18.5cm<sup>2</sup>/g胶粘接厚度：小于等于0.03mm包装：114克/套